

SR-SMD 4.50/05/90 AU BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Сквозная шина, встроенная в монтажную рейку, для модульной системы корпусов для электроники**

Благодаря непрерывному и гибкому системному решению, встроенная в монтажную рейку шина, которая в модульных установках осуществляет электроснабжение, соединение и распределение, позволяет заменить дорогостоящую индивидуальную проводку.

Системная шина надежно интегрирована в 35-миллиметровую стандартную рейку. При изготовлении узлов, с помощью метода пайки Reflow контактный модуль шины для поверхностного монтажа можно обрабатывать в полностью автоматическом режиме. Износостойкие позолоченные поверхности контактов гарантируют неизменно надежный контакт для корпусов любой ширины.

- **Безграничная масштабируемость** - системное решение по соединению независимо от монтажной ширины - от тонкой компактной конструкции 6 мм до крупногабаритного корпуса 67 мм.
- **Удобная для обслуживания установка** - простая замена модуля также в целых модульных системах без помех для соседних модулей.
- **Всеобщая интеграция** - непрерывная системная шина: надежно встроена в 35-миллиметровую стандартную монтажную рейку.
- **Максимальная эксплуатационная готовность** - пять сдвоенных изогнутых контактов с полным гальва-

ническим покрытием и частичной позолотой обеспечивают постоянный контакт с монтажной рейкой с встроенной шиной. Фланцы под пайку THR гарантируют стабильное соединение с печатной платой.

Основные данные для заказа

Исполнение	Штекерный соединитель печатной платы, Шинный контактный блок для CH20M6, Соединение THT/THR под пайку, Количество полюсов: 5, 180°, позолоченный, черный
Номер для заказа	1155850000
Тип	SR-SMD 4.50/05/90 AU BK RL
GTIN (EAN)	4032248942374
Кол.	300 Шт.
Продуктное отношение	IEC: 160 V UL: 300 V / 5 A
Упаковка	Tape

SR-SMD 4.50/05/90 AU BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	5,9 мм	Высота (в дюймах)	0,232 inch
Ширина	16,3 мм	Ширина (в дюймах)	0,642 inch
Длина	24 мм	Длина (в дюймах)	0,945 inch
Масса нетто	1,6 g		

Общие данные

Вид защиты	IP20	Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011
Цветовой код	черный		

Данные о материалах

Группа изоляционного материала	IIIa	Изоляционный материал	LCP
Сравнительный показатель пробоя (CTI)	175 ≤ CTI <400		

Данные о материалах

Изоляционный материал	LCP	Цветовой код	черный
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011	Группа изоляционного материала	IIIa
Сравнительный показатель пробоя (CTI)	175 ≤ CTI <400	Прочность изоляции	≥ 10 ⁸ Ω
Moisture Level (MSL)	1	Поверхность контакта	позолоченный
Температура хранения, мин.	-40 °C	Температура хранения, макс.	70 °C
Рабочая температура, мин.	-50 °C	Рабочая температура, макс.	100 °C
Температурный диапазон монтажа, мин.	-30 °C	Температурный диапазон монтажа, макс.	100 °C

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту	IEC 60664-1, IEC 61984	Номинальный ток, макс. кол-во контактов (T _u = 40 °C)	3,6 A
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2	160 V	Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2	100 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3	63 V	Устойчивость к воздействию кратковременного тока	3 x 1s with 14.5 A
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/3	1,5 kV	Зазор, мин.	2,3 мм
Расстояние утечки, мин.	3,2 мм		

SR-SMD 4.50/05/90 AU BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Номинальные характеристики по UL 1059

Институт (cURus)



Сертификат № (cURus)

E60693

Номинальное напряжение (группа использования В/UL 1059)

300 V

Номинальное напряжение (группа использования С/UL 1059)

50 V

Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059)

50 V

Номинальный ток (группа использования В/UL 1059)

5 A

Номинальный ток (группа использования С/UL 1059)

5 A

Номинальный ток (группа использования D/UL 1059)

5 A

Ссылка на утвержденные значения

В технических характеристиках приведены максимальные значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Классификации

ETIM 6.0

EC001031

ETIM 7.0

EC001031

ETIM 8.0

EC001031

ETIM 9.0

EC001031

ECLASS 9.0

27-18-27-90

ECLASS 9.1

27-18-27-90

ECLASS 10.0

27-18-27-92

ECLASS 11.0

27-18-27-92

ECLASS 12.0

27-18-27-92

ECLASS 13.0

27-18-27-92

Важное примечание

Соответствие IPC

Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

UL File Number Search

Сайт UL

Сертификат № (cURus)

E60693

Загрузки

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

Брошюры

[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](#)
[MB DEVICE MANUF. EN](#)
[FL MACHINE SAFETY EN](#)
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)
[PO OMNIMATE EN](#)
[PO OMNIMATE EN](#)

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

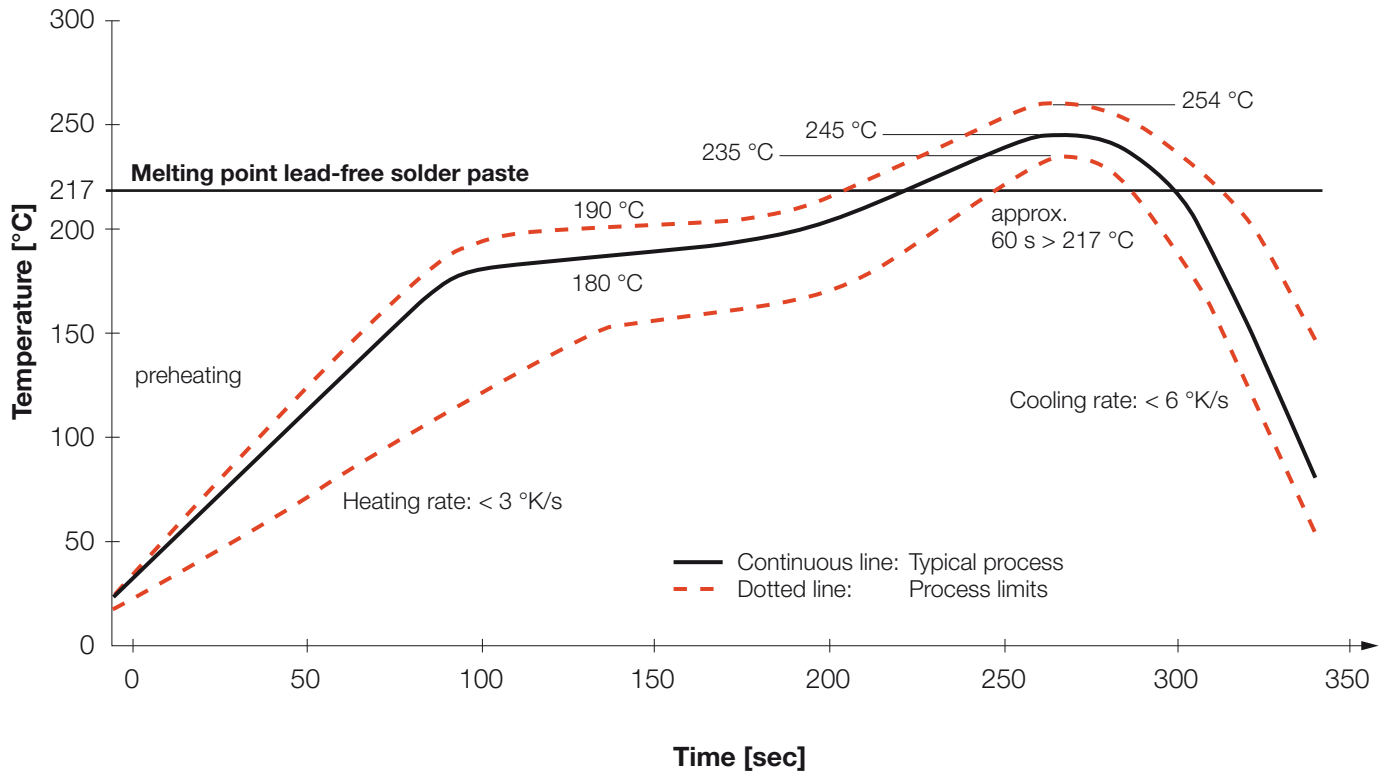
D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.